

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2026-066

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于调整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议、于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议通过了公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件。

2026 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本次调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案事项无需提交公司股东会审议。公司本次发行方案的具体调整内容如下：

调整前：

（4）发行数量

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 20%，即本次发行不超过 40,690,646 股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会或董事会授权人士根据股东会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

.....

(7) 募集资金总额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 97,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	东城利扬芯片集成电路测试项目	131,519.62	70,000.00
2	晶圆激光隐切项目（一期）	10,000.00	8,000.00
3	异质叠层先进封装工艺研发项目	10,000.00	10,000.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	9,000.00	9,000.00
合计		160,519.62	97,000.00

调整后：

(4) 发行数量

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 20%，即本次发行不超过 46,620,788 股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

.....

(7) 募集资金总额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 87,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	东城利扬芯片集成电路测试项目	131,519.62	70,000.00
2	晶圆激光隐切项目（一期）	10,000.00	8,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	9,000.00	9,000.00
合计		150,519.62	87,000.00

除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日